

国开证券股份有限公司

关于

北京天科合达半导体股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）



（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）

二〇二〇年七月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）接受北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“天科合达”、“发行人”或“公司”）的委托，担任天科合达首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（下称“《申报及推荐暂行规定》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京天科合达半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

国开证券股份有限公司。

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定周飞、侯滢担任北京天科合达半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人。

周飞先生：保荐代表人，管理学硕士，现任国开证券投资银行部业务董事，曾主持或参与的项目有：加加食品（002650）、江西长运（600561）、益生股份（002458）、卓翼科技（002369）、京粮控股（000505）、中国广核（003816）等 IPO、再融资及重大资产重组项目，具有丰富的投资银行实务经验。

侯滢女士：保荐代表人，通信工程专业硕士，现任国开证券投资银行部业务董事，曾主持或参与的项目有：淮北矿业（600985）、飞利信（300287）、瀚华金控（03903）、福达股份（603166）等 IPO、再融资及重大资产重组项目，具有丰富的投资银行实务经验。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定牛成鹏为本项目协办人。

牛成鹏先生：准保荐代表人，金融学硕士，现任国开证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：华钰矿业（601020）公开发行可转债、多氟多（002407）公司债等项目，具有丰富的投资银行实务经验。

（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括仵沛志、唐天祥、袁清华。

四、本次保荐的发行人情况

中文名称	北京天科合达半导体股份有限公司
英文名称	TanKeBlue Semiconductor Co., Ltd.
法定代表人	杨建
有限公司成立日期	2006年9月12日
股份公司成立日期	2015年11月20日
注册资本	18,384.00 万元
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣大街9号2幢301室
邮政编码	102600
电话	010-61256850
传真	010-61252062
互联网网址	www.tankeblue.com
电子信箱	info@tankeblue.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
负责人和电话号码	冯四江, 010-61256850-652
经营范围	生产第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片）；研究、开发碳化硅晶片；生产、销售碳化硅单晶生长设备（限外埠从事生产经营活动）；技术咨询、服务、培训、转让；销售自产产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

五、本次证券发行类型

北京天科合达半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

六、本次证券发行方案

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次拟公开发行股票数量不超过 6,128.00 万股，不涉及股东公开发售股份。本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例不低于 25.00%
发行人高管、员工拟参与战略配售情况	发行人高级管理人员、核心员工拟参与本次发行的战略配售。在中国证监会履行完本次发行的注册程序后，发行人将召开董事会审议相关事项，并在启动发行后根据相关法律法规的要求，将高级管理人员、核心员

	工参与本次战略配售的具体情形在招股说明书中进行详细披露，包括但不限于：参与战略配售的人员姓名、担任职务、认购股份数量和比例、限售期限等
保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象
承销方式	余额包销
拟上市地点	上海证券交易所

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本发行保荐书签署日，本保荐机构持有公司300.00万股股份，持股比例为1.63%。本保荐机构的控股股东系国家开发银行，国家开发银行全资子公司国开金融有限责任公司持有发行人股东集成电路基金22.29%股份并持有集成电路基金的管理人华芯投资45.00%股份，集成电路基金持有发行人5.08%股份。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，保荐机构就上述持股情况进行了利益冲突审查。经审查，本保荐机构持股比例较低，未对发行人构成重大影响，其关联方集成电路基金与保荐机构各自独立决策、独立管理，保荐机构不存在因上述持股情况影响其独立、公正开展保荐业务的情形。

本保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

除上述情况外，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况。

（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

截至本发行保荐书签署日，发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐人董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及其配偶拥有发行人权益、在发行人任职情况

截至本发行保荐书签署日，本保荐机构董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及其配偶不存在拥有发行人权益或在发行人任职的情况。

（四）保荐人控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本发行保荐书签署日，本保荐机构控股股东国家开发银行存在向发行人控股股东新疆天富集团有限责任公司及其控股子公司新疆天富能源股份有限公司提供贷款融资的情形。除此之外，本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本发行保荐书签署日，本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序

国开证券根据相关法律、法规和规范性文件要求，建立了包括项目立项、尽职调查、内部审核相关流程的制度。通过立项的项目，项目组应开展全面尽职调查工作，项目申报文件齐备后进入内部审核阶段。

1、质量控制组审核

（1）项目组在保荐及相关业务项目全套发行申请文件齐备后，经必要审核后，向质量控制组报送全套申请文件、现场尽职调查阶段工作底稿和其他内核申请材料。质量控制组应当对项目组尽职调查阶段工作底稿的获取和归集情况进行验收，对相关专业意见和推荐文件是否依据充分，项目组是否勤勉尽责出具明确验收意见。

（2）尽职调查阶段工作底稿验收通过的，质量控制组制作项目质量控制报告，列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论。尽职调查阶段工作底稿验收未通过的，质量控制组应当要求项目组做出解释或补充相关工作底稿后重新提交验收。工作底稿未验收通过的，不得启动内核会议审议程序。

（3）项目全套发行申请文件制作完毕后，项目组将经项目负责人、业务组负责人、部门分管业务组副总经理同意后的内核申请材料提交质量控制组审核。质量控制组在必要的现场核查和底稿验收通过后，方可出具项目质量控制报告。项目组根据质量控制报告修改、补充申请文件，对质量控制报告做出回复和落实情况说明。前述内核申请文件经质量控制组负责人审核后签署意见，报部门分管质量控制组副总经理及投资银行部负责人同意后，提请内核机构进行审核。

（4）履行内核程序前，保荐代表人/项目负责人、项目组成员应接受质量控制组问核。

2、内核管理部审核

（1）经质量控制组审核后，项目组按内核要求提交全部申请文件，并提出内核初审申请。

（2）内核管理部根据项目组申请进行初审，并出具内核初审意见。

(3) 项目组应根据内核初审意见对相关材料 and 文件认真修改、补充和完善，并及时提交书面答复。书面答复经质控组审核确认后提交内核管理部；内核管理部对答复进行审核，无异议后方可提请内核会议审议。

3、内核会议审核

(1) 内核管理部将全部内核申请文件、内核初审意见及项目组的书面答复、会议通知等资料一并报送至参会内核委员，内核委员在内核会议召开前应对全部内核文件进行预审核。

(2) 内核会议由内核委员会主任负责召集、主持，组织内核委员发表意见、讨论、投票等事项。若内核委员会主任不能参会，由内核委员会主任在常设委员中指定一名委员作为当次会议的召集人、主持人。

(3) 内核会议表决方式为封闭式记名投票，即内核委员个人的投票意见不对外公布。投票实行一人一票制，内核委员可填写以下表决意见：同意（包括无条件同意和有条件同意，下同）、反对、暂缓表决。内核委员不得投弃权票，内核委员的投票应填写明确的意见和理由。内核会议应当形成明确的表决意见。内核会议投票表决结果分为：通过（包括无条件通过和有条件通过，下同）、未通过、暂缓表决。表决票中，同意票数达到出席内核会议的内核委员的 2/3 以上（含）时为通过；表决票中，反对票数达到 1/3 以上（不含）时为未通过，其他情况为暂缓表决。对于通过的项目，如出席内核会议的内核委员表决票全部为无条件同意时，则项目为无条件通过，其余表决通过的项目均为有条件通过。对于内核会议暂缓表决的项目，相关事项解决完毕后，项目组可再次申请内核。项目组应对暂缓表决事项的解决情况进行书面说明并相应修改内核申请文件，经质量控制组审核无异议后，提交内核管理部。内核管理部审核确认暂缓表决事项已经解决的，可以安排内核会议审议。暂缓表决的内核申请再次提交内核会议审议时，原则上仍由原内核委员审核。内核会议审议的事项只能暂缓表决一次。

(4) 内核会议后，内核管理部应将内核会议审核结果及内核会议意见反馈给项目组。对内核会议意见，项目负责人应组织项目组认真回答，对需要补充或修改的内容，应及时进行完善。

(5) 内核会议无条件通过的项目，项目组可根据内核决议，按照公司签章管理规定履行申请文件签字、盖章及对外报送程序。对于内核会议有条件通过的

项目，项目组应按照内核会议意见对通过条件进行答复、落实，并书面提交至内核管理部，由内核管理部报送至提出条件的参会内核委员。内核委员应当对内核会议意见的答复、落实情况进行审核，无异议后项目组方可根据内核决议，按照公司签章管理规定履行申请文件签字、盖章及对外报送程序。对于内核会议否决的项目，项目组若重新提交内核申请，程序同首次申请；同时，应对项目前后差异、前次否决原因及相应整改情况等进行专项书面说明。项目在内核会议审议通过、对外报送前，如出现新情况、新问题，项目组应及时将具体情况报送内核管理部；内核管理部评估后确定是否需要重新履行内核程序。

（二）内核委员会意见

2020年6月24日，本保荐机构内核委员会就天科合达申请首次公开发行股票并在科创板上市项目召开了内核会议。内核委员会经过投票表决，认为发行人申请文件符合有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关要求，同意推荐发行人股票发行上市。

九、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目中有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：

（一）本保荐机构不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为

本保荐机构在发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

（二）发行人依法聘请中介机构及有偿聘请其他第三方的情况

经核查，发行人分别聘请了国开证券股份有限公司、国浩律师（杭州）事务所和立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为首次公开发行股票并在科创板上市

项目的保荐机构、法律顾问和审计机构。除以上依法有偿聘请的证券服务机构之外，还聘请了中信建投证券股份有限公司作为本次发行的联席主承销商；由于撰写本次募集资金投资项目的可行性研究报告需要，发行人还聘请了信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司对募集资金投资项目进行了可行性分析，并出具了可行性研究报告；由于核查境外专利情况需要，发行人聘请了境外法律顾问日本特许业务法人酒井国际特许事务所和美国 ARCH & LAKE LLP；由于翻译境外销售合同需要，发行人聘请了专业翻译机构北京润知泽行科技咨询有限公司。

经本保荐机构核查，除上述情况外，发行人在首次公开发行股票并在科创板上市项目中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目中有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

第二节 保荐机构承诺事项

本保荐机构承诺：

一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

二、本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、上海证券交易所规定的其他事项。

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、对本次证券发行的推进结论

依照《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，经核查，本保荐机构认为：

（一）发行人符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》及《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，履行了相关内部决策程序；

（二）发行人法人治理结构健全，运作规范，主营业务突出，科技创新能力突出，在同行业中具有较强的竞争优势；

（三）发行人生产经营及本次募集资金投资项目符合国家产业政策、具有良好的市场发展前景。本次募集资金投资项目实施后将进一步增强发行人的可持续发展能力和竞争实力。

二、发行人符合《科创属性评价指引（试行）》、《申报及推荐暂行规定》规定的科创属性标准

（一）发行人符合科创板行业领域要求

发行人是从事第三代半导体材料——碳化硅领域相关产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括碳化硅晶片、碳化硅晶体和碳化硅单晶生长炉。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发行人属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专用材料制造”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，发行人碳化硅晶体与晶片产品属于“1 新一代信息技术”之“1.2.3 高性能和关键电子材料制造”和“3 新材料产业”之“3.4.3.1 半导体晶体制造”。因此，发行人符合科创板行业领域中的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”产业和“新材料领域”之“前沿新材料”产业。

（二）发行人科创属性符合标准

1、发行人符合“科创属性评价标准一”要求

发行人符合“科创属性评价标准一”全部三项指标要求，具体情况如下：

发行人最近三年累计研发投入为 5,669.63 万元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 22.03%，符合《申报及推荐暂行规定》第四条第一款“最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 6,000 万元以上”的要求。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司拥有专利 34 项，其中国内发明专利 27 项、实用新型 1 项，国际发明专利 6 项，均与发行人主营业务收入相关，符合《申报及推荐暂行规定》第四条第二款“形成主营业务收入的发明专利 5 项以上”的要求。

2017 年、2018 年以及 2019 年，发行人营业收入分别为 2,406.61 万元、7,813.06 万元和 15,516.16 万元，年均复合增长率为 153.92%，符合《申报及推荐暂行规定》第四条第三款“最近三年营业收入复合增长率达到 20%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元”的要求。

2、发行人符合“科创属性评价标准二”要求

除满足“科创属性评价标准一”全部指标外，发行人还符合“科创属性评价标准二”第一款和第四款规定，具体情况如下：

根据科技部对公司独立承担的国家科技支撑计划项目《宽禁带半导体材料碳化硅晶体产业化开发》验收意见：公司半绝缘（碳化硅）晶片产品和导电型（碳化硅）晶片产品达到了国际同类产品的先进水平，打破了国外对半绝缘晶片的严格禁运，建立了国内第一条碳化硅晶片中试生产线，为国产碳化硅材料在微波功率器件、电力电子器件和高亮度发光器件等领域的应用奠定了基础。发行人符合《申报及推荐暂行规定》第五条第一款“拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义”。

发行人主要产品为《“十三五”国家科技创新规划》、《产业结构调整指导

目录（2019年本）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》所规定的国家鼓励、支持和推动的关键材料。公司建立了国内第一条碳化硅晶片中试生产线，打破了国外对半绝缘晶片的严格禁运，推进了半导体碳化硅材料的国产化进程，实现了进口替代。发行人符合《申报及推荐暂行规定》第五条第四款“依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代”。

综上所述，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》和《申报及推荐暂行规定》等相关要求。

三、本次证券发行履行的决策程序

本保荐机构对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了核查。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序。具体情况如下：

（一）董事会审议过程

2020年5月20日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》等相关议案。

（二）股东大会审议过程

2020年6月4日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》等相关议案。

（三）第八师国资委的批复

2020年5月25日，第八师国资委出具师国资发（2020）23号《关于北京天科合达半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的批复》，同意本次发行方案。

四、对本次证券发行是否符合《证券法》发行条件的核查

本保荐机构依据《证券法》第十二条规定，对发行人是否符合首次公开发行股票条件进行逐项核查，认为：

（一）具备健全且运行良好的组织机构

本保荐机构查阅了发行人的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度文件、三会文件、发行人会计师出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZB11266 号）等资料。经核查，发行人已建立起由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司法人治理架构，并在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，按照自身生产经营管理的需要设置了职能部门，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（二）具有持续盈利能力

本保荐机构查阅了业务合同、发行人会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB11260 号）等资料。经本保荐机构核查，报告期内，发行人营业收入分别为 2,406.61 万元、7,813.06 万元、15,516.16 万元和 3,222.93 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-2,034.98 万元、194.40 万元、3,004.32 万元和 439.77 万元，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（三）最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

本保荐机构查阅了立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB11260 号）。经核查，发行人最近三年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

根据本保荐机构的核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（五）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

根据本保荐机构的核查，发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，具体核查情况详见本节“五、对本次发行是否符合《科创板首发管理办法》发行条件的核查”。

五、对本次发行是否符合《科创板首发管理办法》发行条件的核查

本保荐机构依据《科创板首发管理办法》对发行人是否符合首次公开发行股票并在科创板上市的条件进行了逐项核查，核查情况如下：

（一）本次发行符合《科创板首发管理办法》第十条的规定

本保荐机构核查了发行人设立、改制的工商登记资料，创立大会决议及审计报告、评估报告、验资报告等材料。经核查，发行人系由天科合达有限按原账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。天科合达有限成立于 2006 年 9 月 12 日，于 2015 年 11 月 20 日依法整体变更为股份有限公司，发行人依法设立至今持续经营 3 年以上。

本保荐机构核查了发行人报告期内的股东大会及董事会、监事会文件。经核查，发行人已建立并健全股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、董事、监事、高级管理人员均勤勉尽责，按相关制度规定切实行使权力、履行义务。发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

（二）本次发行符合《科创板首发管理办法》第十一条的规定

根据立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB11260 号）及《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZB11266 号），并经本保荐机构核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。

（三）本次发行符合《科创板首发管理办法》第十二条的规定

本保荐机构采取了访谈和实地走访发行人、主要股东及关联方等核查方式，核验了发行人的业务完整性。发行人资产完整，业务、人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

本保荐机构查阅了报告期内的销售合同，确认发行人致力于第三代半导体材料碳化硅领域相关产品研发、生产和销售，最近两年内主营业务没有发生变化。

本保荐机构查阅了发行人公司章程、历次股东大会、董事会、监事会资料，确认发行人最近两年内董事、高级管理人员、核心技术人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

本保荐机构查阅了发行人工商档案资料，访谈了发行人股东及高级管理人员，确认发行人股权清晰，受实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。根据国浩律师出具的《法律意见书》，并查阅发行人主要资产的权属文

件、访谈发行人高级管理人员，本保荐机构认为，发行人不存在主要资产的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，以及经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

（四）本次发行符合《科创板首发管理办法》第十三条的规定

根据相关政府部门出具的证明文件，并经核查主要股东出具的声明与承诺、查询公开信息，本保荐机构认为，发行人生产经营活动符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经核查发行人董事、监事和高级管理人员简历及声明承诺，查阅股东大会、董事会和监事会资料，查询公开信息，本保荐机构认为，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

六、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查

本保荐机构按照中国证监会《发行监管问答——关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题的解答》的要求，就发行人股东是否属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金以及是否按规定履行备案程序事项，查询了发行人股东工商登记资料、发行人股东提供的《私募投资基金备案证明》，并通过中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）进行了独立查询。通过上述尽职调查，核查结论如下：

经核查，发行人共有 104 名股东，其中 87 名为自然人股东，17 名为法人股东或非法人组织股东。非自然人股东中，天富集团、中科院物理所、哈勃投资、宁波风展投资、广州天石投资、北京骏豪融生、北京林华体育、国开证券、广东德沁六号、广东将苑健康产业发展有限公司等 10 名股东不属于私募投资基金；

集成电路基金、厦门中和致信、河南新安财富、北京中科创星、青岛比特丰泽、广东德沁资产、北京新材智创业投资合伙企业（有限合伙）等 7 名股东均已按照相关规定履行了私募投资基金备案及私募投资基金管理人登记程序。

七、发行人存在的主要风险

（一）技术风险

1、技术研发风险

公司所处的半导体材料行业为技术密集型行业，第三代半导体产品的研发周期长、研发难度高、研发投入大。随着技术水平的逐步提高，下游行业对碳化硅晶片性能及尺寸的要求也越来越高，若公司不能继续保持充足的研发投入，在关键技术上未能持续突破，亦或新产品技术指标无法达到预期，将导致公司与国际龙头企业的差距持续扩大甚至被国内同行业竞争对手赶超，对公司的盈利能力将造成重大不利影响。

2、核心技术泄密风险

公司经过多年的持续研发投入，掌握了覆盖碳化硅晶片生产的“设备研制—原料合成—晶体生长—晶体切割—晶片加工—清洗检测”的全流程关键技术和工艺，建立了拥有自主知识产权的核心技术体系，这些核心技术是公司能够保持较强竞争力的关键所在。若公司在日常经营过程中因管理不善、外部窃取等原因导致核心技术泄密，将对公司的市场竞争力和盈利能力产生不利影响。

3、关键技术人才流失风险

我国第三代半导体碳化硅晶片产业起步较晚，国内关键技术人才非常稀缺。具有丰富经验的技术团队是公司取得竞争优势的关键。随着我国碳化硅晶片行业的持续发展，人才竞争将不断加剧，如公司关键技术人才流失，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

（二）经营风险

1、宏观经济及行业波动风险

碳化硅晶片行业处于碳化硅产业链的上游，是碳化硅和氮化镓器件的重要衬底材料，其需求直接受到下游功率器件、射频器件制造及终端应用的影响。如果未来全球宏观经济发生剧烈波动，新能源汽车、5G 通讯、光伏发电、轨道交通等终端市场需求下降，导致下游功率器件、射频器件等终端应用产品的产销规模下滑，将对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

2、产业政策变化风险

第三代半导体碳化硅晶片制造属于国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业。为实现我国第三代半导体产业的快速发展，我国政府近年来出台了一系列产业扶持政策，以推动包括碳化硅晶体与晶片制造在内的第三代半导体产业链的发展。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司经营业绩和后续发展产生一定不利影响。

3、国际贸易争端加剧风险

近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，贸易保护主义风潮不断加剧，以美国为代表的西方发达国家开始推动中高端制造业回流，对全球半导体产业的发展带来较大不确定性。如果相关国家（地区）对中国贸易争端进一步加剧，对第三代半导体相关产品限制进出口或提高关税，将对公司的产品销售、原材料采购和设备采购造成不利影响，从而影响公司的生产经营和业务扩张。

4、原材料价格波动和供应风险

报告期内，发行人原材料成本占主营业务成本比例较高，是公司产品成本的重要组成部分。公司生产碳化硅晶体及衬底晶片的主要原材料包括高纯碳粉、高纯多晶硅等主材，以及石墨件、石墨毡、研磨液、抛光液等耗材；生产碳化硅单晶生长炉的主要原材料包括不锈钢炉体、电控系统、中频电源等部件。原材料成本在公司生产成本中占比较高，其价格波动会对公司业绩产生一定的影响。

此外，因生产过程中对石墨件等原材料的技术要求较高，目前国内能够供应的合格材料相对较少，公司部分原材料需向国外厂商采购。若未来公司主要原材料价格大幅波动或者供应不足，将对公司的生产经营造成不利影响。

5、市场竞争加剧风险

碳化硅单晶材料是半导体产业的前沿和核心之一，具有较高的经济和战略重要性。很长时间内，碳化硅单晶的核心技术和市场基本被西方发达国家控制，且产品尺寸越大、质量越高，其市场及技术优势越显著。近年来随着我国对半导体产业的高度重视，在产业政策和地方政府的推动下，我国第三代半导体碳化硅行业的新建项目也不断涌现，中国正逐步成长为全球第三代半导体材料生产的主要竞争市场之一。公司未来将面临来自国际先进企业和国内新进企业的双重竞争，存在市场竞争加剧的风险。

6、下游行业发展不及预期导致的需求风险

随着全球第三代半导体的快速发展，近年来国内第三代半导体材料和器件需求旺盛，下游厂商对碳化硅器件的投资不断加大，公司在报告期内也相应持续扩大产能，晶片供给能力不断提升。未来如下游器件研发或市场应用不及预期，将影响行业对碳化硅衬底材料的需求，公司可能面临产品售价下降、库存上升等风险，将对公司的盈利能力产生不利影响。

7、规模扩张和跨区域管理的风险

报告期内，公司经营规模不断扩大，营业收入持续增长。随着业务规模的扩张和跨区域生产经营，公司的管理半径随之扩大、管理难度逐步提高，在技术研发、生产加工、市场营销、内控管理等方面将会对公司管理层提出新的挑战。如果管理水平无法适应公司的快速发展，管理制度得不到有效落实，将会影响公司的技术研发和生产经营，对公司的发展带来不利影响。

8、部分生产经营场所通过租赁取得的经营风险

截至报告期末，除子公司新疆天科合达拥有房屋建筑物外，公司及沈阳分公司、子公司天科新材料、江苏天科合达的生产经营场所均系租赁取得，其中江苏天科合达所租赁厂房已签订远期购买相关协议。公司所租赁厂房中，碳化硅单晶生长炉生产业务的经营场所可替代性较强，碳化硅晶体生长及晶片加工业务环节对厂房洁净度要求较高、装修周期较长。若上述租赁房产出现出租方提前终止租赁合同等情形，公司将需寻找替代房产，对公司生产经营可能产生一定影响。

9、新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险

2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全球多个国家和地区遭受不同程度的影响。我国中央和地方政府出台严格的防控措施以应对疫情蔓延，公司严格按照疫情防控要求，积极开展疫情应对措施，保障公司核心业务未出现停工停产情形，但疫情仍对公司原材料和设备采购、订单及时交付等产生了一定影响。目前国内疫情已基本得到控制，但国外部分国家和地区疫情防控形势仍较为严峻，如未来疫情出现反复，将可能对公司生产经营产生不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款回收风险

报告期内，公司业务规模持续扩大，销售收入快速增长，应收账款也相应增加，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 691.04 万元、605.43 万元、2,813.18 万元和 2,582.91 万元，增长较快。随着公司收入的快速增长，应收账款规模预计将继续增加，如公司客户信用状况发生变化或公司收款措施不力，可能导致坏账增加，对公司经营造成不利影响。

2、应收票据回收风险

报告期内，随着公司销售收入增长，客户以承兑汇票方式结算的货款大幅增长，其中商业承兑汇票规模也明显增长。截至报告期末，公司应收票据（含计入应收款项融资的银行承兑汇票）账面价值共计 2,060.30 万元，其中商业承兑汇票 1,226.90 万元。

报告期各期末，公司应收票据中商业承兑汇票主要为大型国有单位承兑的票据，且不存在到期未兑付的情形，但未来如承兑方财务状况和信用状况发生不利变化，公司应收票据将存在无法回收的风险。

3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为2,008.60万元、2,869.18万元、5,914.35万元和8,114.54万元。报告期内，公司碳化硅晶片产品和其他相关产品的市场需求持续增长，公司持续扩大产能，因此，报告期各期末，公司存货余额呈持续增长趋势。尽管目前下游市场对于碳化硅晶片产品的需求旺盛，但未来如下

游客户需求发生不利变化、市场竞争加剧或公司未能及时优化存货管理，将导致公司存货出现积压，存货跌价风险增大，进而对公司经营产生不利影响。

4、无法持续享受税收优惠政策的风险

报告期内，公司及子公司新疆天科合达为高新技术企业，享受 15% 企业所得税优惠税率，此外，公司享受软件产品增值税即征即退税收优惠。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月，公司税收优惠金额分别为 0 万元、0 万元、1,028.38 万元和 311.71 万元，占同期公司利润总额的比例分别为 0%、0%、36.78% 和 87.33%。未来如相关税收优惠政策发生重大调整，或公司不再满足税收优惠条件，公司将无法持续享受相关税收优惠，进而对公司经营产生不利影响。

5、政府补助减少的风险

报告期内，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 632.80 万元、768.89 万元、2,045.17 万元和 516.66 万元。2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月政府补助占同期公司利润总额的比例分别为 534.05%、73.14% 和 144.75%（2017 年公司利润总额为负），比例较高；报告期各期末，公司因政府补助形成递延收益余额分别为 430.57 万元、529.49 万元、13,080.81 万元和 14,208.74 万元，规模较大。未来，如政府部门对碳化硅及相关产业支持力度减弱，或公司不满足申请相关政府补助所要求的条件，导致公司取得政府补助减少，将对公司业绩产生不利影响。

6、盈利规模较小且存在累计未弥补亏损导致的风险

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-2,034.98 万元、194.40 万元、3,004.32 万元和 439.77 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-2,572.06 万元、-420.11 万元、1,219.21 万元和 151.03 万元，公司盈利规模较小；截至报告期末，公司合并报表未分配利润为-1,522.49 万元。2017 年以前，由于公司持续研发投入，以及受碳化硅半导体材料工业化应用进程较慢影响，公司持续亏损，累计未弥补亏损规模较大。2018 年以来，随着公司产品生产工艺的成熟和下游需求的增加，公司收入规模快速增长，并实现持续盈利，累计未弥补亏损规模持续减小，但截至报告期末，合并财务报表的未分配利润仍然

为负。若公司无法完全弥补以前年度的累计亏损，将存在短期内无法向股东进行利润分配的风险。

（四）法律风险

1、控股股东持股比例较低的风险

本次发行前，公司控股股东天富集团持有公司 24.15% 股份，本次发行完成后，控股股东持股比例将进一步降低，股权结构的进一步分散在一定程度上可能会影响股东大会对于重大事项的决策效率，进而影响公司的业务发展。

2、知识产权保护风险

公司主要从事第三代半导体碳化硅晶片及相关产品的研发、生产和销售。经过多年的研发投入和积累，公司在技术上取得了丰硕成果。公司一直以来高度重视知识产权的保护，通过申请专利、注册商标、内部保密等多种措施保护知识产权。但是，由于行业内技术进步加快，科技含量提高，若公司对侵犯知识产权的行为未能及时发现并采取有效的法律措施，可能会对公司的品牌形象和利益产生负面影响，而公司通过法律途径维护自身合法权益，也会消耗公司的经济资源，从而对公司正常生产经营造成不利影响。

（五）本次发行失败的风险

1、发行认购不足的风险

根据相关法规要求，若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法定要求，本次发行应当终止；若公司上市审核程序超过交易所规定的时限或者终止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，将导致公司存在发行失败的风险。

2、未能达到预计市值上市条件风险

科创板新股发行的询价、定价、配售等环节均受到询价对象的较大影响。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》，公司预计发行后总市值由发行后总股本乘以发行价格计算所得，其中发行价格不仅取决于公司的经营业

绩，还受到询价对象对公司发展前景判断、市场情绪等诸多外部因素的影响，因此，公司存在预计发行后总市值低于所选市值标准，进而中止发行的风险。

（六）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资实施风险

本次募集资金拟投资于第三代半导体碳化硅衬底产业化基地建设项目，新增建设年产 12 万片 6 英寸碳化硅晶片的生产基地。若因项目建设进度、生产技术、内部管理水平、市场变化等因素导致募集资金投资项目未能达到预期收益，将会影响该项目的投资回收期及投资收益。

2、新增非流动资产折旧、摊销影响公司经营业绩的风险

公司募集资金到位后，公司的股本和净资产规模将进一步扩大，随着募集资金投资项目的建设和投产，预计未来公司收入规模和利润规模将有所提升，但募集资金投资项目从建设到达产运行需要时间，募集资金投资项目购置和投入的大量非流动资产在短期内会增加公司的折旧、摊销金额，如募集资金投资项目未能按照预期实现收益，公司的净利润和净资产收益率等财务指标将存在下降的风险。

（七）同行业可比公司经营数据无法获取的风险

国内同属于碳化硅晶片行业的可比公司均为非上市公司，未公开披露详细的财务及业务相关数据；国外可比公司属于多主业经营的上市公司，在公开信息中未披露细分业务的分部信息详情，因此发行人无法获得可比公司关于相关业务的生产经营和财务数据。由于同行业可比公司公开信息的缺失，投资者难以直观和全面地判断发行人与竞争对手之间的差异，将对投资者做出投资决策造成不利影响。

八、本保荐机构对发行人发展前景的简要评价

由于碳化硅在新能源汽车、5G 通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等战略新兴产业领域具有广泛应用前景，第三代半导体材料的重要性和战略地位得到广泛重视，全球对碳化硅晶片衬底的器件需求持续增长。

（一）发行人在行业中竞争优势明显

1、技术优势

（1）自主知识产权优势

公司在成立初期通过和中科院物理所深入合作研究，并在后续产业化过程中不断研发投入，已经形成并掌握了自主可控的、具有关键性和基础性作用的碳化硅晶片材料生长与加工、碳化硅设备制造的工艺与技术，并基于上述技术积累形成了多项核心专利。上述技术积累打破了国外先进企业的技术与专利封锁，能够尽可能保证公司产品生产、业务拓展的独立性与完整性，保证公司技术演进与产品迭代的持续性与稳定性。拥有较多自主的核心技术与知识产权积累可以促进公司碳化硅晶片产品顺利实现国内进口替代以及全球销售。

（2）技术先发优势

碳化硅衬底材料是支持第三代新型半导体产业发展的基础材料，其产业化时间较短，技术难度大，对持续研发投入要求较高。碳化硅衬底产品的制造涉及设备研制、原料合成、晶体生长、晶体切割、晶片加工、清洗检测等诸多环节，每个环节的工艺与技术细微差异均会影响最终碳化硅衬底产品的参数与合格率。因此，碳化硅衬底制备技术的提高需要反复的理论推导、生产验证，以及长期的大量的工艺技术积累。

公司自 2006 年成立以来，一直专注于碳化硅晶体和晶片生产加工，是国内最早从事碳化硅晶片产业化的企业。经过近 15 年的持续研发投入与技术积累，公司攻克一系列碳化硅衬底产品生产领域的技术难点，在国内率先成功研制 6 英寸碳化硅晶片，并已实现 2 英寸至 6 英寸的碳化硅晶片的规模化生产和销售，技术积累与产业化进度处于行业前列。此外，公司还牵头起草碳化硅晶片领域 3 项国家标准，参与起草 1 项国家标准和 2 项电子行业标准，推动了我国碳化硅产业技术的整体进步。

公司目前已经掌握覆盖碳化硅晶片生产各个环节的核心技术，并形成了规模化供应碳化硅衬底晶片的技术能力，在行业内具有明显技术先发优势。

2、生产优势

(1) 碳化硅晶片生产全产业链优势

我国碳化硅行业起步较晚，且在行业发展初期一直处于科研院所的研究阶段，未进入工业化生产。公司通过从无到有的研发与经营，成为国内首家探索并实现碳化硅产业化的企业。由于没有成熟的技术和工艺可供借鉴，公司在中科院物理所初步研发成果基础上通过不断探索，掌握了覆盖碳化硅晶片生产的“设备研制—原料合成—晶体生长—晶体切割—晶片加工—清洗检测”全流程关键技术和工艺，填补了国内碳化硅产业上游的材料制造的空白，使公司能够参与碳化硅材料全产业链的市场竞争，有效提高公司的行业地位和核心竞争力。

(2) 国内产能优势

半导体产业伴随全球信息技术与制造产业的更新迭代持续快速发展，碳化硅作为第三代半导体材料产业化最为成熟的材料，具有巨大的市场应用空间。

碳化硅衬底作为基础性材料，对终端设备性能和稳定性有着重要影响，下游加工企业在选择材料供应商时对其稳定供货能力具有较为严格的考量。因此，产能规模与持续供货能力决定了碳化硅材料制造企业的行业地位及与合作客户的稳定性。拥有完备的产品体系和规模化的供货能力将有利于下游客户降低其供应链管理的难度、提升产品品质和保持供应链的稳定性，相应地增强了公司获取客户能力和客户粘性。

近年来，以 CREE 公司为代表的国际碳化硅巨头公开宣布超过十亿美元的碳化硅材料扩产投资计划，以满足下游市场的需求。公司作为国内产能规模最大的碳化硅衬底制造企业之一，经过多年发展已分别在北京、江苏和新疆建有 3 个生产基地。公司可以为客户稳定供应 2 英寸至 6 英寸的高品质碳化硅晶片，形成与客户稳定的合作关系。在公司经营规模不断提升的背景下，公司有效产能也在持续增加，帮助公司在碳化硅产业快速发展阶段掌握市场先机。

3、团队优势

(1) 团队专业优势

第三代半导体行业技术准入门槛较高，公司通过持续 10 余年的人才引进及自主培养，建立了一支能力出众的管理团队和技术团队，包含博士、硕士近 50 人。公司先后被北京市科学技术委员会认定为“北京科技研究开发机构”，荣获科技部授予的“十一五”国家科技计划执行优秀团队奖、新疆生产建设兵团科学技术进步奖一等奖等荣誉。公司研发团队先后承担和参与了国家科技支撑计划项目、国家“02 专项”项目、国家“863 计划”项目、国家重点研发计划项目、国家新材料生产应用示范平台建设项目等重大科研项目二十余项。专业的管理和技术团队是公司持续创新、保持技术先进性的源动力，也为公司快速发展奠定了良好的技术基础。

（2）团队稳定优势

半导体行业是典型的技术密集型和人才密集型行业，专业的管理与技术人才是半导体行业企业的宝贵财富。企业的持续健康发展很大程度上取决于研发、管理人员的创新能力和技术水平，其中专业研发人员更是公司核心竞争力的支柱之一。

公司高度重视碳化硅产业专业人才培养与保护，建立了合理的激励措施，核心管理人员和研发人员均持有公司股份，大幅提高核心团队成员的稳定性与积极性，为公司中长期发展对稳定团队的要求提供了保障，在业内人才竞争日益激烈的情况下为公司提供了团队稳定优势。

4、市场优势

公司是国内最早从事碳化硅晶片产业化的企业，通过多年的业务合作，逐步积累了深厚的客户资源。公司的碳化硅衬底通过下游厂商已用于国产功率器件和微波器件的生产，客户包括三安集成、株洲中车时代、泰科天润、东莞天域、瀚天天成等重要的下游外延和器件厂商。

在与行业知名客户合作过程中，公司已经具备了与客户协同研发的能力，能满足客户对产品定制、技术支持等方面的要求。经过多年的合作，公司已经熟练产业链协同发展的合作流程，同时加深了对核心技术的理解与掌握，能够更精准、更快速为外延、器件厂商提供技术咨询支持，优化技术方案，满足客户产品生产

与研发的差异化需求，在下游客户中获得了良好的口碑，不断扩大公司产品的市场份额以及公司在产业链的地位。同时，公司通过与下游外延、器件客户的协同发展，促进了碳化硅全产业链的快速发展，进一步提升公司在碳化硅及整个半导体行业的市场影响力。

目前，公司产品已经出口美国、欧洲、日本等多个国家和地区，天科合达（TankeBlue）已成为行业国际知名品牌，连续多年被国际著名半导体咨询机构 Yole Development 列为全球碳化硅晶片主要制造商之一。

（二）发行人业务发展规划

公司自设立以来专注于第三代半导体碳化硅材料的技术研究、开发与生产。随着国家将第三代半导体材料的研发与生产定位于重点支持行业，结合我国碳化硅市场仍处于新兴起步阶段，公司的发展战略定位仍为聚焦于碳化硅的研发及生产，保持技术的领先性、巩固并不断提升公司在行业的地位，并致力于提升碳化硅半导体材料国产化率，为国内外企业提供品质一流的材料产品，推动碳化硅的行业发展。公司以实现“促进第三代半导体产业的发展，成为全球碳化硅材料行业的领导者”为企业愿景。

本保荐机构认为：根据发行人产品应用领域的行业发展前景、发行人目前的竞争优势和未来发展战略，发行人具有突出的自主创新能力和持续经营能力。

九、对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况

根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告[2013]45号）的要求，保荐机构对发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况进行了核查。保荐机构认为，上述期间内，公司的生产经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国开证券股份有限公司关于北京天科合达半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 牛成鹏

牛成鹏

保荐代表人签名: 周飞 侯滢

周飞

侯滢

保荐业务部门负责人签名: 廖邦政

廖邦政

内核负责人签名: 武红

武红

保荐业务负责人签名: 郑文杰

郑文杰

保荐机构总经理(总裁)签名: 郑文杰

郑文杰

保荐机构法定代表人、董事长签名: 张宝荣

张宝荣

保荐机构: 国开证券股份有限公司

2020年7月10日



